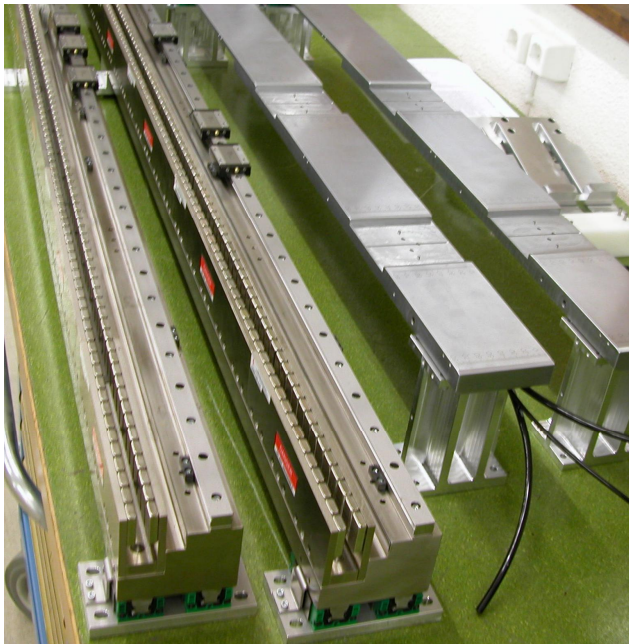


Referenzbericht

Komponentenbau für Chip Bonder Maschinen August 2009



Durrer liefert für ESEC zwei komplette Komponenten: Das Transportmodul und den Auflagentisch.

Die enge Zusammenarbeit mit dem ESEC Entwicklungsteam ermöglichte es, die Konstruktion der Teile so zu beeinflussen, dass die Fertigungsabläufe wesentlich optimiert werden konnten.



Mit der neuesten Generation von „Chip-Bonder“ Maschinen unterstreicht die ESEC ihre Marktführerschaft im Bereich der Chipmontageautomaten. Geschwindigkeit und Genauigkeit setzten neue Massstäbe im hart umkämpften Markt. Durrer fertigt und montiert für diese Präzisionsmaschinen zwei Komponenten: das Transportmodul und den Arbeitstisch. Beide Komponenten werden nach dem „Just-in Time“ Prinzip gebaut und geliefert. Dazu gehört die Beschaffung und Verwaltung von diversen Kaufteilen.

Die Toleranz der 1400 mm langen Fertigungsteile liegt im Bereich von max. 1/100 mm pro 300 mm im fertig montierten Zustand. Höchste Präzision in der Fertigung und standardisierte Produktionsabläufe sind entscheidend. Dank eigens entwickelten Aufspannvorrichtungen und dem langjährigem Fertigungs-Know-how gelang es Durrer, die gewünschte Genauigkeit und Oberflächen-güte zu erreichen. Zudem ist bei der von Durrer gewählten Vorgehensweise keine zusätzliche Schleifoperation nötig. Neben der Teilefertigung ist Durrer ebenfalls für die Montage und die protokollierte Qualitätskontrolle aller Teile verantwortlich.

